



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110429001
2011 年 4 月 29 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

TI-Philippines 製造 PBGA パッケージ 一部製品 代替 Substrate 部材追加のご案内

平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

日本での震災は、TI 美浦工場（茨城県、東京の北東 40 マイル(64km)）被害に加えて、弊社 IC パッケージ供給チャンネルにも一部影響を与えました。TI は一日も早い供給フローの正常化に向け、他供給業者からの支援の下懸命に作業しております。

今回のお知らせは、BGA パッケージ Substrate 代替部材追加についての連絡になります。お客様への供給停滞を最小限にとどめる為にも、本通知記載の対象製品について追加部材の認定を迅速に実施してまいります。

TI は現行最善の情報及び知識に基づき本通知に盛り込むべく全ての方策を行っていますが、再度変更追加があった場合には、本通知の更新にて連絡させていただきます。

次ページに詳細を掲載いたしました。お客様におかれましては、本通知発行日より **21** 日以内に本通知受領のご確認をお願いいたします。TI は、供給遅延を最小限にとどめるために、5 月の出荷が開始されるべく追加部材認定を実施する予定です。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業あるいはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	TI-Philippines 製造 PBGA パッケージ 一部製品 代替 Substrate 部材追加 現行 : 認定 Substrate 変更後: 認定 Substrate, Hitachi 社製 Substrate			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	5 月の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容：弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト)/ASP-MCU(マイクロコントローラ) TI-Philippines(フィリピン)サイト製造 PBGAパッケージ 一部製品について、震災状況下での供給能力確保の為、代替Substrate部材追加の連絡になります。一部部材の供給制限のため、認定試験終了次第、本代替部材の追加変更は直ちに実施予定です。認定終了前のいかなる製品出荷についても、事前顧客承認が必要になります。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

Substrate 部材

現行

認定 Substrate

変更後

認定 Substrate

Hitachi 社製 Substrate

理由：供給能力確保の為

製品表示

この変更による製品捺印、出荷ラベルの変更はありません。部材識別については、弊社標準のロット追跡及び製造手順によりトレーサビリティは確保されます。

対象製品リスト

対象製品名				
AM1707BZKB3	D790E002BZDH300	DRA446A1ZEDQ1M	TMS320C28346ZFET	TMS320C6747BZKB3
AM3505AZERQ5	D810K003BZKB300	DRA457A1ZEQQ1M	TMS320C6421ZDU4	TMS320C6747BZKBA3
AM3517AZER	D810K003BZKBT300	DRA457B1ZEQQ1M	TMS320C6424ZDU4	TMS320C6747BZKBT3
AM3517AZERA	D810K003BZKBT400	DRA526AZERRQ1	TMS320C6424ZDU6	TMS320DM6435ZDU5
D710E001BZDH275	D810K013BZKB400	DRH407B1ZDUQ1	TMS320C6424ZDUQ6	TMS320DM6437ZDU6
D710E001BZDH300	D81YK113BZKB300	DRH416B1ZDUQ1	TMS320C6727BGDH300	TMS320DM6437ZDU7
D710E001BZDHA275	D81YK113BZKB400	DRH443B1ZDUQ1	TMS320C6727BZDH250	TMSDC6727BGDHA250
D710E002BZDHA275	D830K003BZKB300	DR1416B1ZDUQ1	TMS320C6727BZDH275	TMSDC6727BZDHA250
D790E001BZDH275	D830K013BZKB300Z	OMAPL137BZKB3	TMS320C6727BZDH300	TNETC4710ZDW
D790E001BZDH300	DRA407B1ZDUQ1	OMAPL137BZKBA3	TMS320C6727BZDH350	TNETV1055NNZDW
D790E001BZDH300Z	DRA416B1ZDUQ1	PDR1459A1ZEQQ1	TMS320C6727ZDH300	TVP9001ZDS

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 8 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	F771558ZXZ/ DRA457BIZEQRQ1		Substrate:	Hitachi Substrate
Package:	PBGA		Site(s):	PHI
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration			Sample Size
Material Property Comparison	Specification Review			per spec
Preconditioning	JEDEC L-4/260C			539
High Temperature Storage Life	150C, 600hrs Note (1)			45
Temperature Cycle	-55C/125C, 1000cyc			231
Temperature Humidity Bias	85C/85%RH, 600hrs Note(1)			77
UnBiased HAST	130C/85%RH, 96hrs			231
Note (1): Qualification Device release at 600hrs, other device Qual by Similarity/Bridge at 1000hrs				